

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2024-026

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日上午11:00-12:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开了2023年度业绩暨现金分红说明会，针对公司2023年经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2024年6月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司《关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临2024-025），并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2023年6月14日上午11:00-12:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动的方式召开了2023年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生、独立董事刘海燕女士出席了本次说明会，针对公司2023年度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题1：**请问，2024年二季度已至尾声，相较一季度，二季度行业市场是否持续转暖？

**回答：**您好，公司专注于集成电路先进封装技术工艺开发和量产服务，封装的产品广泛应用在智能手机、安防监控，IOT，汽车电子、医疗等终端市场。2023年 Q4 以来，消费类电子市场得益于行业补库存的需求，CIS 市场需求呈现恢复性趋势，同期业务增长明显。在汽车电子领域，公司作为全球车规 CIS 芯片晶圆级 TSV 封装技术的开发者，拥有显著的技术与量产领先优势，随着智能驾驶技术的渗透率，生产规模持续快速增长。在非 CIS 芯片应用领域，公司通过技术工艺的持续创新与客制化开发，在 MEMS、FILTER 等领域开始实现商业化应用。同时，公司在光学器件领域的业务规模拓展也在有效推进，目前公司拥有荷兰和苏州园区双中心，并具备领先的精密光学设计、晶圆级光学加工，精密玻璃加工及光学系统模块集成与制造能力，服务于欧洲和全球半导体设备企业，精密量测设备企业和汽车行业。基于以上各细分市场的发展趋势，以及公司具备的技术、市场与产业链能力，公司在今年一季度业绩恢复增长趋势，我们希望今年接下来的几个季度，都能保持向上成长的趋势，感谢您的关注。

**问题2：**请问，公司子公司晶方光电的光学器件、物镜等产品可否在光刻机设备上应用？

**回答：**公司精密光学器件业务主要产品包括混合镜头、微镜头阵列、超精密光学器件加工件等等，相关产品主要应用在半导体光刻设备、工业智能、汽车智能投射等市场终端，感谢您的关注。

**问题3：**请问，公司控股的荷兰Anteryon公司，产品是否有供应国内？

**回答：**Anteryon公司具备独特的微型精密光学器件的设计和制造能力，通过设立荷兰和中国的双制造中心，公司可以同时服务于包括欧洲和其他国家和地区的客户需求，感谢您的关注。

**问题4：**请问，公司的氮化镓功率器件业务进展如何？是否已为公司创造收益？

**回答：**公司通过投资以色列VisIC公司，为市场提供基于硅基氮化镓技术的400V/800V汽车逆变器方案。VisIC公司的D3GAN技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点，与其他氮化镓技术和碳化硅技术相比，其成本和性能优势明显，目前VisIC已经和多家欧洲和美国的汽车厂商产生芯片和模块设计的合作，合作内容可以参考VisIC公司网站信息，感谢您的关注。

**问题5:** 请问王董，现在产线是不是满负荷生产，新的园区能不能如期在七月投产，正式投产后产能能增加多少？回购满足什么条件能够触发，是不是不看好现在的增持价？

**回答:** 关于公司的生产运营与市场业务情况，请见前述回复。公司产业园项目正在有效实施推进，并将逐步进入收尾、验收、投入运营的阶段。关于回购股份事宜，公司会根据市场情况及相关法律法规的要求择机推进，感谢您的关注。

**问题6:** 王董，国家大基金三期已于5月24日注册成立，请问公司的发展方向是否契合大基金的投资方向？

**回答:** 我们也关注到大基金三期的成立，并将密切关注其未来的投资策略与方向，感谢您的关注。

**问题7:** 王总，您好，我想了解一下晶方科技2024年经营复苏情况，以及车规级半导体SiC公司预计年销售额和利润有多少？晶方光电最近发展怎么样？

**回答:** 关于公司今年市场及业务情况，请见前述答复！感谢您的关注。

**问题8:** 公司CIS封装业务在消费类电子、汽车等各应用领域的景气度与市场发展趋势；公司投资的以色列VisIC公司业务拓展情况，什么时候能够在汽车市场上获得商业化应用？为应对当前的国际贸易形势，公司有何应对措施？

**回答:** 关于公司CIS封装业务、VisIC业务拓展等相关情况，请见前述回复。为应对全球产业发展新形势，公司一方面根据不断变化的市场需求，持续推进技术创新开发，不断拓展新的应用领域；另一方面公司将持续推进海外产业链拓展与国际化布局，进一步整合海外并购项目的业务协同，同时设立新加坡子公司，拓展公司海外业务中心、研发工程中心与投融资平台，并以此为基础布局生产基地，以更好贴近海外客户需求，感谢您的关注。

**问题9:** 请问，公司今年的研发投入预计有多少？重点研发方向是什么？

**回答:** 公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善。公司成立以来，始终注重技术的研发投入与持续创新，一步步发展为全球传感器领域先进封装技术的引领者，2021年、2022年以及2023年公司研发费用占公司销售收入的比重分别达到13%、17%、15%，2024年公司仍将保持对研发的持续投入，通过对

技术、工艺的持续创新开发，继续聚焦包括车用摄像头技术，高密度封装互连技术，3D MEMS技术和5G射频芯片封装技术等研发方向，感谢您的关注。

**问题10：**公司今年第一季度业务快速增长，目前公司封装业务市场与产能利用情况如何，如何看待下半年的市场走势？先进封装技术成为未来的发展趋势，公司TSV封装技术有没有新的项目开发或者未来有何新的项目储备？公司收购的荷兰子公司及光学相关业务发展状况，相关产品的主要应用场景及未来发展趋势？

**回答：**公司今年的业务、荷兰子公司光学业务情况请见前述回复。随着集成电路产业快速发展，先进封装技术将在产业中扮演越来越重要的角色，公司作为晶圆级TSV先进封装技术的领先者，拥有完整的8英寸和12英寸的封装技术与规模量产能力。TSV技术是高密度互连，3D芯片集成，Chiplet等技术方向的重要组成部分，以满足包括AI运算，高带宽通讯，汽车电子带来的集成电路封装需求和挑战，感谢您的关注。

### 三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2024年6月15日